

## 杭州迪普科技股份有限公司

### 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下：

#### 一、申请授信额度的具体事宜

公司及合并报表范围内子公司拟分别向银行申请授信额度，预计合计不超过 8.00 亿元，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、票据贴现等，该授信额度不代表公司的实际融资金额，具体合作机构、授信条件、利率及使用方式等，以双方正式签署的协议为准。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。

公司及子公司根据相关机构要求，分别以各自资产进行担保，包括以土地使用权进行抵押、以知识产权进行质押等，合计不超过 8.00 亿元。具体合作机构、融资金额、抵押及质押方式以签署正式协议或合同为准。

授权公司法定代表人或管理层人员在上述额度内全权签署有关合同、协议、凭证等所需的相关文件，办理相关手续。

该额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止。公司以往董事会核准已生效的相关融资安排自本议案审议批准之日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。

#### 二、对公司的影响

本次公司及合并报表范围内子公司分别向金融机构申请授信额度有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，对公司生产经营无重大不利影响。

#### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日